

0525强势股脱水 | 华为包场了？

2026/05/25 18:29

“

①半导体：作为大陆半导体晶圆代工龙头，环比增速超台积电，核心驱动来自AI需求向成熟制程的系统性溢出——配套芯片需求旺盛、海外产能转移订单回流、客户提前备货多线共振，代工服务平均售价进入结构性上行周期，公司凭借完备工艺平台及先进封装布局，有望持续兑现这一周期红利。

②硅通孔：华为论文将TSV技术与3D芯片堆叠深度绑定，公司作为晶圆级硅通孔封装技术领先者，以车规CIS封装为核心、光学器件为第二增长曲线，叠加MEMS、AI眼镜、机器人等新兴应用的商业化落地，以及马来西亚产线的全球化布局，正在构建多场景覆盖的先进封装平台，机构预计三年内营收及净利润均实现翻倍以上增长。

③EDA：华为“韬定律”要求EDA工具将多个堆叠芯片视为一个连续设计实体，从需求侧宣告了3D原生工具时代的到来。国内EDA市场2025至2027年复合增长率预计达35.4%，国产晶圆厂独特工艺路径形成了海外工具无法覆盖的空白市场，叠加政策“反内卷、促整合”方向，具备3DIC全流程设计能力和PDK生态覆盖的龙头企业，有望率先从“点状突破”跨越至“系统性替代”。

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。

1、中芯国际：秋季见真章

(1) 大涨题材：半导体

华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波今日发表“韬（τ）定律”，这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。

据介绍，“韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。据介绍，第一个作品——将于今年秋季面世的麒麟手机芯片率先采用了逻辑折叠技术，性能大幅提升。

受此影响，半导体产业链今日掀起涨停潮，国内晶圆代工龙头中芯国际今日大涨18.78%。



(2) 研报深度复盘（华泰证券、东方证券、中邮证券）：AI需求外溢，拐点明确

①机构认为公司作为中国大陆唯一可规模化量产先进制程的平台上市公司，兼具产业链重构的战略稀缺性，当前的增长兑现仅是一个开始。

②而这轮业绩上行周期的核心驱动，是AI需求从高端向成熟工艺的系统性溢出，而非单一季度的超预期。

公司26年一季度收入25.05亿美元，环比增长0.7%，毛利率20.1%，略超前指引上限。更关键的是26年二季度指引——收入环比增长14%至16%，对应约28.81亿美元，显著高于台积电同期约10%的环比增速指引。

③具体业务看，是多条线索叠加的结果：AI大模型的高速扩张正在拉动电源管理、数字传输、BCD等配套芯片的旺盛需求，这些芯片主要在成熟工艺上生产；

与此同时，海外代工厂将产能向AI相关产品切换，标准产品产能收缩，订单加速回流至国内，公司作为国内最大晶圆代工厂，是这轮回流的最大承接方。

此外，端侧AI、电动汽车、机器人等新兴应用需求也在持续放量。产业链国产化进程下逻辑、网通系统芯片需求同步提升。多路需求共同指向同一个结论：**代工服务的平均售价（ASP）已进入结构性上行周期。**

④公司在产能和业务方向上的前置布局，决定了其能否充分兑现这轮需求。26年一季度资本开支约15.63亿美元，相当于全年计划的约20%，公司预计全年资本支出规模与上年基本持平。重点投入方向包括：专用存储、PMIC、模拟（含BCD）等需求快速增长的平台；同时成立先进封装研究院，设立子公司。

目前先进封装被明确视为未来新的业务增长点。另外，收购中芯北方49%少数股权的工作正按计划推进，完成后有望增厚归属上市公司股东净利润。

2、TSV：实现突破的重要技术之一

(1) 大涨题材：硅通孔+半导体

依然是华为“韬”催化，在华为何庭波发布主旨演讲后，华为又发布了一篇论文，详细介绍了这些新技术和进展。

技术细节很多，其中一项提到“未来十年，此次突破的核心技术LogicFolding（逻辑折叠）有望从局部关键路径折叠发展到全规模多层折叠——每个封装三层、四层甚至更多层——这得益于低温混合键合技术（降低各层之间的热预算）以及TSV接地从顶层金属向下迁移至M6层，从而释放超过30%的高级布线资源。”

TSV指Through Silicon Via，硅通孔技术，是通过硅通道垂直穿过组成堆栈的不同芯片或不同层实现不同功能芯片集成的先进封装技术。TSV主要通过铜等导电物质的填充完成硅通孔的垂直电气互连，减小信号延迟，降低电容、电感，实现芯片的低功耗、高速通信，增加带宽和实现器件集成的小型化需求。

行情上，晶方科技等涨停。

02



(2) 研报深度复盘（中邮证券、西部证券、国元证券）：有技术，但用处还有待升级

①2025年，公司芯片封装及测试业务实现收入11.35亿元，同比增长49.90%，成为核心驱动力。这一高增速来自两个支撑：一是持续优化TSV-STACK等车规工艺，加速A-CSP、I-BGA等创新工艺量产，在车规CIS领域建立技术壁垒；二是在安防监控、智能手机等成熟领域巩固份额，向中高像素产品线有效延伸。

②TSV作为公司核心技术，本质是一项先进封装的底层能力，其价值不仅体现在当前的CIS产品封装上，更在于可向多个新兴场景扩展。目前公司通过Cavity-Last、TSV-LAST工艺，已在MEMS、FILTER等领域持续提升量产规模。在AI眼镜、机器人、全景相机等新兴领域，已实现商业化量产。这意味着公司的增长天花板并不局限于传统CIS市场。

③公司通过并购荷兰ANTERYON，形成了光学器件设计制造及一体化异质集成能力，相关产品已在半导体设备、工业智能、车用智能投射等领域落地，2025年光学及其他收入3.24亿元，同比增长10.54%。此外，公司正与以色列VisiC加强协同，布局高功率氮化镓技术，以把握三代半导体在新能源汽车、算力中心等领域的产业机遇。

3、EDA：华为包场了

(1) 大涨题材：EDA

催化同样来自上述论文，在“未解决的挑战”一篇中，华为何庭波提到“当今的EDA开发于一个以面积、时序和功耗三个独立维度进行优化的时代，系统 τ 只是一个剩余部分。全尺寸逻辑折叠要求工具链将多个堆叠芯片视为一个连续的设计实体”。

方法论细节将在未来几个月内公布。一个 τ 原生工具链——开放的、多物理场的、3D原生的——是未来十年最重要的赋能投资。

机构认为，韬定律有望推动EDA从“制程驱动”转向“设计驱动”。

行情上，华大九天、概伦电子等多股大涨。



股票名称	最新价	涨跌幅
华大九天 301269.SZ 转亏·拟增持 公司是国内领先的 EDA 软件开发商，产品覆盖模拟电路设计、数字电路设计、平板显示电路设计等多个领域，是国内少数能够提供全流程 EDA 解决方案的企业	125.04	+15.04%
概伦电子 688206.SS 公司专注于 EDA 工具的自主设计和研发，在器件建模和电路仿真两大关键环节掌握核心技术，能提供制造类、设计类 EDA 工具及全流程解决方案，产品被全球领先集成电路企业广泛验证和使用	45.15	+13.19%
广立微 301095.SZ 拟减持 公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案	112.22	+8.97%
一博科技 301366.SZ 扭亏 公司拥有基于外购标准软件自主二次开发的 EDA 设计软件，主要用于为客户提供 PCB 设计及制造服务	46.76	+8.27%
紫光国微 002049.SZ 参股公司紫光同创专注于可编程系统平台芯片及其配套 EDA 工具的研发与销售	85.02	+6.63%
安路科技 688107.SS 拟减持 公司作为国内领先的 FPGA 芯片供应商，自主研发了 TD、FD 等专用 EDA 软件，为 FPGA、FPSoc 芯片开发提供从逻辑资源开发、工程管理到代码编辑、编译调试等完整的工具链及相关服务	48.78	+4.30%

(2) 研报深度复盘（浙商证券、华创证券、申万宏源）：国产加速突围

①EDA是一个市场体量极小、战略价值极大的特殊行业。全球EDA市场规模约157亿美元，仅占6310亿美元半导体产业的2.5%，却是整条产业链的“底座”。先进制程下，这一底座的价值还在加速提升——28纳米流片成本超1000万美元，7纳米接近1亿美元，EDA直接决定流片成功率，成本权重持续上升。随着AI驱动芯片复杂度每年约增长50%，而设计效率仅提升20%，EDA对设计提效的重要性越来越突出，已从“辅助手段”转变为“核心资产”。

②国内EDA市场正处于高速扩张期，但结构性矛盾同样突出。机构预计2025至2027年中国EDA市场规模从193亿元增至354亿元，复合增长率35.4%，增速显著高于全球。

然而，高速增长之下，碎片化困局尚未破解：国内企业数量众多，但普遍聚焦“点工具”，缺乏全流程整合能力；截至2022年，全球三大巨头在中国市场的合计份额仍超过70%。此外，人才缺口、资本内卷、生态壁垒三重约束并存，制约着国产EDA从“点状突破”向“系统性替代”跨越。从美国经验看，EDA巨头的护城河靠的不是单点技术，而是数十年“政府扶持+密集并购”构建的全流程平台——仅Synopsys和Cadence两家，参与并购事件就超过200起。

③华大九天是当前最具代表性的国产EDA龙头标的。2025年，公司成功推出11款EDA核心工具、构建9大关键核心解决方案，数字电路设计产品种类已覆盖主要工具的80%。尤为值得关注的是：公司是国内唯一的3DIC设计验证全流程EDA提供商，已构建从异构集成三维芯片协同设计到验证的完整解决方案，新推出业界领先的Argus 3DIC物理验证平台。

生态建设方面，开发的PDK套件已覆盖国内晶圆代工厂70%以上的工艺节点。机构预计公司2026至2028年收入从17.65亿元增至29.54亿元，**三年内实现翻倍级=增长。**

研报来源:

华泰证券，黄乐平，S0570521050001，AI需求外溢推动2Q指引超预期，2026年5月16日。

东方证券，蒯剑，S0860514050005，AI需求带动运营情况持续向好，2026年5月19日。

中邮证券，吴文吉，S1340523050004，再上新台阶，2026年5月22日。

中邮证券，吴文吉，S1340523050004，车规CIS与光学器件双轮驱动业绩跃升，2026年3月17日。

西部证券，王昊哲，S0800525080003，半导体设备零部件25年报及26Q1业绩复盘，2026年5月17日。

西部证券，曹森元，S0800524100001，后摩尔时代，玻璃基板或开启新一轮"材料革命"，2026年5月17日。

国元证券，彭琦，S0020523120001，长江存储开发TSV封装技术，台积电2nm制程涨价，2025年9月29日。

浙商证券，邱世梁，S1230520050001，反内卷促整合，国产EDA突围正当时，2026年1月22日。

华创证券，吴鸣远，S0360523040001，AI+EDA双轮驱动，全流程覆盖加速突破，2026年5月17日。

申万宏源，黄忠煌，A0230519110001，AI、先进工艺提升EDA行业景气度，2026年5月20日。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

本资讯中的内容来自持牌证券机构，意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。亦不应以本资讯取代自己的判断。

本文内容和观点不代表选股通APP平台观点，请独立判断和决策。在任何情况下，选股通APP不对任何人因使用本平台中的内容所引致的任何损失负任何责任。